

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会 2026 年第三次会议，会议审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度为不超过 15 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东会授权董事会并由董事会授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日